

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本文件全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**SEMICONDUCTOR MANUFACTURING INTERNATIONAL CORPORATION**

**中芯國際集成電路製造有限公司\***

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：0981)

### 中芯國際截至二零一零年三月三十一日止三個月業績公佈

- 二零一零年第一季的總銷售額超越原先指引，由二零零九年第四季之三億三千三百一十萬元上升 5.6%至三億五千一百七十萬元，與二零零九年第一季相比上升 140.1%。
- 二零一零年第一季的毛利率由二零零九年第四季的 7.6%改善至 14.6%是，由於晶圓付運及平均售價增加所致。
- 二零一零年第一季來自於經營活動的現金淨額由二零零九年第四季的八千九百三十萬元增加至一億五千三百一十萬元。
- 二零一零年第一季普通股持有人應佔虧損收窄至一億八千一百九十萬元；相對二零零九年第四季六億一千七百七十萬元。
- 每股美國預托股股份淨虧損(攤薄)為 0.41 元。

以下為本公司於二零一零年五月十一日就截至二零一零年三月三十一日止三個月的未經審核業績公佈全文。

所有貨幣數位主要以美元列賬，除非特別指明。

報告內的財務報表數額按美國公認會計原則厘定。

**中國上海 — 2010年5月11日 — 國際主要半導體代工製造商中芯國際集成電路製造有限公司(紐約交易所：SMI；香港聯交所：981)(「中芯」或「本公司」)於今日公佈截至二零一零年三月三十一日止三個月的綜合經營業績。**

## 二零一零年第一季度概要

- 二零一零年第一季的總銷售額超越原先指引，由二零零九年第四季的三億三千三百一十萬元上升 5.6%至三億五千一百七十萬元，與二零零九年第一季相比上升 140.1%。
- 二零一零年第一季的毛利率由二零零九年第四季的 7.6%改善至 14.6%是，由於晶圓付運及平均售價增加所致。
- 二零一零年第一季來自於經營活動的現金淨額由二零零九年第四季的八千九百三十萬元增加至一億五千三百一十萬元。
- 二零一零年第一季普通股持有人應佔虧損收窄至一億八千一百九十萬元；相對二零零九年第四季六億一千七百七十萬元。
- 每股美國預托股股份淨虧損(攤薄)為 0.41 元。

## 二零一零年第二季指引

以下聲明為前瞻性陳述，此陳述基於目前的期望並涵蓋風險和不確定性，部分已於之後的安全港聲明中闡明。

- 二零一零年第二季收入預期增加 3%至 5%。
- 經營開支去除匯兌損益預期介乎於八千萬至八千四百萬美元之間。
- 資本支出預期介乎於一億五千萬元至兩億美元之間。

在評論季度業績時，中芯國際總裁兼首席執行官王寧國博士表示：「在 2010 年的第一季度，隨產著品組合的改善，我們的平均售價有所提高，產能利用率改善至 92.1%，而毛利率亦改善至 14.6%。從地區來看，北美和中國繼續是我們大部份的收入來源和季度的增長動力。其中北美貢獻我們過半的收入且增長了 10.2%，而中國貢獻了近四分之一的收入和增長了 17.6%。我們看到 90 納米及以下製程的收入提高了 14.3%，而我們預期毛利率將穩步提高。

晶圓代工市場看起來是正面的。我們繼續看到在第二季度的上升趨勢並保持的對於第三和第四季度的謹慎樂觀。我們將繼續加強公司的組織和業務並定時向投資界交待最新發展，我們感謝您的支持。要達到持續盈利仍然是我們不變的目標，而我們將全力加強中芯國際的基礎從而實踐進一步的擴充。」

本公司根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.09(1)條規定的披露責任於二零一零年五月十一日作出本公佈。

---

## 電話會議／網上業績公佈詳情

日期：二零一零年五月十二日

時間：上海時間上午八時三十分

撥號及登入密碼：美國 1-617-614-3672(密碼：SMIC)或香港 852-3002-1672(密碼：SMIC)

二零一零年第一季度業績公佈網上直播可於 [www.smics.com](http://www.smics.com) 網站「投資者關係」一欄收聽。中芯網站在網上廣播後為期十二個月提供網上廣播錄音版本連同本新聞發佈的軟拷貝。

---

## 關於中芯國際

中芯國際集成電路製造有限公司(“中芯國際”，紐約證交所股票代碼:SMI，香港聯合交易所股票代碼: 981)，是世界領先的集成電路芯片代工企業之一，也是中國內地規模最大、技術最先進的集成電路芯片代工企業。中芯國際向全球客戶提供 0.35 微米到 45 納米芯片代工與技術服務。中芯國際總部位於上海，在上海建有一座 300mm 芯片廠和三座 200mm 芯片廠。在北京建有兩座 300mm 芯片廠,在天津建有一座 200mm 芯片廠，在深圳有一座 200mm 芯片廠在興建中，在成都擁有一座封裝測試廠。中芯國際還在美國、歐洲、日本提供客戶服務和設立營銷辦事處，同時在香港設立了代表處。此外，中芯代成都成芯半導體製造有限公司經營管理一座 200mm 芯片廠，也代武漢新芯集成電路製造有限公司經營管理一座 300mm 芯片廠。

詳細信息請參考中芯國際網站 <http://www.smics.com>

---

## 安全港聲明

(根據1995 私人有價證券訴訟改革法案)

本次新聞發佈可能載有(除歷史資料外)依據1995 美國私人有價證券訴訟改革法案的“安全港”條文所界定的「前瞻性陳述」。該等前瞻性陳述，包括我們看到第二季度收入持續上升的趨勢、我們對下半年保持審慎樂觀、公司要達到持續盈利的目標和“2010 年第二季度指引”等聲明乃根據中芯對未來事件的現行假設、期望及預測而作出。中芯使用「相信」、「預期」、「打算」、「估計」、「期望」、「預測」、「有信心」或類似的用語來標識前瞻性陳述，儘管並非所有前瞻性聲明都包含這些用語。該等前瞻性陳述乃反映中芯高級管理層根據最佳判斷作出的估計，存在重大已知及未知風險、不確定性，以及其他可能導致中芯實際業績、財政狀況或經營結果與前瞻性陳述所載資料存在重大差異的因素，包括(但不限於)與半導體行業周期及市場狀況有關的風險、全球經濟衰退及其對中國經濟的影響、激烈競爭、中芯客戶能否及時接收晶圓產品、能否及時引進新技術、中芯抓住在中國發展機遇的能力、中芯於加強全面產品組合的能力、半導體代工服務供求情況、行業產能過剩、設備、零件及原材料短缺、能否取得生產力，終端市場的財政穩定、中芯股價將來的變動和將來潛在的訴訟和索償。

投資者應考慮中芯呈交予美國證券交易委員會(「證交會」)的文件資料，包括其於二零零九年六月二十二日以 20-F 表格形式呈交給證交會的年報，特別是在「風險因素」和「管理層對財務狀況和經營業績的討論與分析」部分，並中芯不時向證交會(包括以 6-K 表格形式)，或香港交易所(「港交所」)呈交的其他文件。其他未知或不可預測的因素也可能對中芯的未來結果，業績或成就產生重大不利影響。鑒於這些風險，不確定性，假設及因素，本次新聞發佈中討論的前瞻性事件可能不會發生。請閣下審慎不要過分依賴這些前瞻性聲明，因其只於聲明當日有效，如果沒有標明聲明的日期，就截至本新聞發佈之日。除法律有所規定以外，中芯概不負責因新資料、未來事件或其他原因引起的任何情況，亦不擬更新任何前瞻性陳述。

---

## 訴訟

本公司與台積電於二零零九年十一月九日訂立和解協議（「二零零九年和解協議」），取代二零零五年和解協議，平息一切未決訴訟，其中包括在加利福尼亞州提出訴訟，陪審團於二零零九年十一月四日對中芯國際作出判決。二零零九年和解協議解決雙方之間一切未決訴訟，而雙方均撤銷一切未決訴訟。二零零九年和解協議的主要條款包括：

- 1) 作出判決後，雙方解除所有已經或可能已經訴諸待決訴訟的指控；
- 2) 終止中芯國際根據二零零五年和解協議項下餘下款項（約40百萬美元）的付款責任；
- 3) 向台積電支付合共200百萬美元（於簽訂協議時支付15百萬美元，資金將以中芯國際現有現金結餘撥付，餘額將於四年內分期支付）
- 4) 承諾授予台積電1,789,493,218股中芯國際股份（佔中芯國際於二零零九年十月三十一日已發行股本約8%）及一份可認購695,914,030股中芯國際股份的認股權證（可予調整及於發行後三年內行使），認購價為每股1.30港元。股份及認股權證讓台積電可於股份發行落實後獲得中芯國際已發行股本總控股權約10%，惟須待接獲政府及監管機構批准，方可作實；及
- 5) 倘違反本次和解，則採取若干補救措施。

---

## 或然負債

二零零八年，本公司與並無關連的半導體製造商（「訂約對手」）訂立設備購買及合作製造安排（「安排」）。該合作製造安排按計劃在二零零八年結束。二零零九年，本公司接獲訂約對手通知，本公司須承擔額外設備搬遷費用及於合作製造安排期內產生的部分虧損。本公司已提出異議，並要求訂約對手提供申索的進一步支持理據。訂約對手亦於二零零九年年底就部分申索提出要求爭議仲裁。本公司計劃繼續與訂約對手進行調查及談判。總申索金額約為4千5百萬美元。本公司將預期支出的責任索償金額之最佳估計金額於二零零九年十二月三十一日及截至該日止年度的合併財務報表中入帳。

截至此報告之日期，公司繼續評估或然負債和保持其在綜合財務報表就責任估計可能索賠的賠償金額。

---

## 二零一零年第一季經營業績概要：

以千美元為單位(每股盈利和百分比除外)

	二零一零年 第一季度	二零零九年 第四季度	季度比較	二零零九年 第一季度	年度比較
銷售收入	351,724	333,090	5.6%	146,519	140.1%
銷售成本	300,270	307,669	-2.4%	275,900	8.8%
毛利(虧損)	51,454	25,421	102.4%	(129,381)	-
經營開支	79,496	622,244	-87.2%	46,681	70.3%
經營虧損	(28,042)	(596,823)	-95.3%	(176,062)	-84.1%
其他費用，淨額	(155,567)	(29,178)	433.2%	(4,480)	3372.5%
所得稅利益	2,374	8,735	-72.8%	3,305	-28.2%
稅後淨虧損	(181,235)	(617,266)	-70.6%	(177,238)	2.3%
應佔聯營公司虧損	(455)	(114)	299.1%	(874)	-47.9%
淨虧損	(181,690)	(617,380)	-70.6%	(178,111)	2.0%
非控制權益持有人利息	(259)	(274)	-5.5%	(259)	0.0%
普通股持有人應佔虧損	(181,949)	(617,655)	-70.5%	(178,370)	2.0%
毛利率	14.6%	7.6%		-88.3%	
經營利潤率	-8.0%	-179.2%		-120.2%	
每股普通股股份淨虧損－基本 <sup>(1)</sup>	(0.01)	(0.03)		(0.01)	
每股美國預托股股份淨虧損-基本	(0.41)	(1.38)		(0.40)	
每股普通股股份淨虧損－攤薄 <sup>(1)</sup>	(0.01)	(0.03)		(0.01)	
每股美國預托股股份淨虧損-攤薄	(0.41)	(1.38)		(0.40)	
付運晶圓(8吋等值) <sup>(2)</sup>	455,010	436,816	4.2%	168,743	169.6%
產能使用率	92.1%	91.5%		34.9%	

附注：

(1) 基於二零一零年第一季加權平均普通股 223 億 9 千 7 百萬股(基本)及 223 億 9 千 7 百萬股(攤薄)，二零零九年第四季 223 億 7 千萬股(基本)及 223 億 7 千萬股(攤薄)，二零零九年第一季 223 億 4 千 4 百萬股(基本)及 223 億 4 千 4 百萬股(攤薄)。

(2) 包括銅接連件

- 二零一零第一季總銷售額由二零零九年第四季的 3 億 3 千 3 百 10 萬元上升至 3 億 5 千 1 百 70 萬元，錄得季度升幅 5.6%，是由於晶圓付運上升所致。
- 二零一零年第一季的銷售成本與二零零九年第四季的 3 億零 7 百 70 萬元相比，下降 2.4% 至 3 億零 30 萬元。

- 二零一零年第一季的毛利為 5 千 1 百 50 萬元，相對二零零九年第四季 的 2 千 5 百 40 萬元及二零零九年第一季的負 1 億 2 千 9 百 40 萬元。
- 二零一零年第一季的毛利率由二零零九年第四季的 7.6%改善至 14.6%，主要是由於晶圓付運及平均售價增加所致。
- 二零一零年第一季的總經營開支與二零零九年第四季的 6 億 2 千 2 百 20 萬元相比，錄得 季度降幅 87.2%至 7 千 9 百 50 萬元。季度降幅由於公司在本季內的一般行政費用減少以及二零零九年第四季發生較高的長期資產減值損失和訴訟和解費用所致。
- 二零一零年第一季的研發費用與二零零九年第四季的 4 千 3 百 80 萬元相比，錄得 季度降幅 0.5%至 4 千 3 百 60 萬元。
- 二零一零年第一季的一般行政費用與二零零九年第四季的 1 億 5 千 1 百 50 萬元相比 下降至 1 千 7 百 60 萬元，是由於律師費用及壞帳費用減少所致。
- 二零一零年第一季的銷售和市場推廣費用由二零零九年第四季的 780 萬元下降至 600 萬元，錄得季度降幅 22.1%。

## 收入分析

銷售分析			
以應用分類	二零一零年 第一季度	二零零九年 第四季度	二零零九年 第一季度
電腦	4.3%	6.2%	4.2%
通訊	51.5%	49.0%	50.9%
消費	37.0%	38.3%	32.9%
其他	7.2%	6.5%	12.0%
以服務分類	二零一零年 第一季度	二零零九年 第四季度	二零零九年 第一季度
邏輯 <sup>(1)</sup>	90.3%	90.2%	85.3%
記憶	2.7%	3.4%	2.8%
光罩製造，探測及其它	7.0%	6.4%	11.9%
以客戶類別分類	二零一零年 第一季度	二零零九年 第四季度	二零零九年 第一季度
無廠房半導體公司	66.4%	64.4%	70.9%
集成裝置製造商	17.0%	17.4%	11.4%
系統公司及其它	16.6%	18.2%	17.7%
以地區分類	二零一零年 第一季度	二零零九年 第四季度	二零零九年 第一季度
北美洲	58.9%	56.4%	60.4%
中國 <sup>(2)</sup>	24.4%	21.9%	21.4%
歐亞 <sup>(3)</sup>	16.7%	21.7%	18.2%
晶圓收入分析			
各技術佔晶圓銷售額的百分比	二零一零年 第一季度	二零零九年 第四季度	二零零九年 第一季度
90 納米及以下	20.3%	18.7%	8.2%
0.13 微米	35.5%	39.5%	30.8%
0.15 微米	1.5%	2.7%	0.8%
0.18 微米	24.2%	22.9%	31.5%
0.25 微米	0.3%	0.3%	0.4%
0.35 微米	18.2%	15.9%	28.3%

附注：

- (1) 包括 0.13 微米銅接連件
- (2) 包括香港
- (3) 不包括中國

• 90 納米及以下製程的晶圓收入於二零一零年第一季佔總晶圓收入 20.3%，相比二零零九年第四季的 18.7%。

## 產能\*

晶圓廠／(晶圓尺寸)	二零一零年 第一季度	二零零九年 第四季度
上海廠(8吋)	84,000	85,000
北京廠(12吋)	46,800	42,750
天津廠(8吋)	34,300	34,300
每月晶圓裝配總產能	165,100	162,050

附注：

\*每月期終8吋等值晶圓

## 付運及使用率

8吋等值晶圓	二零一零年 第一季度	二零一零年 第四季度	二零零九年 第一季度
付運晶圓(包括銅接連件)	455,010	436,816	168,743
使用率 <sup>(1)</sup>	92.1%	91.5%	34.9%

附注：

(1) 產能使用率按輸出品圓總額除以估計產能計算

- 二零一零年第一季晶圓付運數量較二零零九年第四季的 436,816 片 8 吋等值晶圓增加 4.2%至 455,010 片 8 吋等值晶圓，較二零零九年第一季度的 168,743 片 8 吋等值晶圓錄得年度升幅 169.6%。



## 詳細財務分析

### 毛利分析

以千美元計	二零一零年 第一季度	二零零九年 第四季度	季度比較	二零零九年 第一季度	年度比較
銷售成本	300,270	307,669	-2.4%	275,900	8.8%
折舊	143,919	142,196	1.2%	158,000	-8.9%
其他製造成本	155,119	162,501	-4.5%	111,166	39.5%
遞延成本攤銷	-	1,962	-	5,886	-
股權報酬	1,232	1,010	22.0%	848	45.3%
毛利 (虧損)	51,454	25,421	102.4%	(129,381)	-
毛利率	14.6%	7.6%		-88.3%	

- 二零一零年第一季的銷售成本與二零零九年第四季的3億零7百70萬元相比，下降2.4%至3億零30萬元。
- 二零一零年第一季的毛利為5千1百50萬元，相對二零零九年第四季的2千5百40萬元及二零零九年第一季的負1億2千9百40萬元。
- 二零一零年第一季的毛利率由二零零九年第四季的7.6%改善至14.6%，主要是由於晶圓付運及平均售價增加所致。

### 經營開支分析

以千美元計	二零一零年 第一季度	二零零九年 第四季度	季度比較	二零零九年 第一季度	年度比較
總經營開支	79,496	622,244	-87.2%	46,681	70.3%
研究及開發	43,592	43,806	-0.5%	18,494	135.7%
一般及行政	17,601	151,520	-88.4%	14,928	17.9%
銷售及市場推廣	6,045	7,760	-22.1%	4,208	43.7%
無形資產攤銷	6,886	7,641	-9.9%	9,031	-23.7%
資產處置損失	233	3,585	-93.5%	20	1065.0%
長期資產減值損失	5,138	138,295	-96.3%	-	-
訴訟和解	-	269,637	-	-	-

- 二零一零年第一季的總經營開支與二零零九年第四季的6億2千2百20萬元相比，錄得季度降幅87.2%至7千9百50萬元。季度降幅由於公司在本季內的一般行政費用減少以及二零零九年第四季發生較高的長期資產減值損失和訴訟和解費用所致。
- 二零一零年第一季的研發費用與二零零九年第四季的4千3百80萬元相比，錄得季度降幅0.5%至4千3百60萬元。
- 二零一零年第一季的一般行政費用與二零零九年第四季的1億5千1百50萬元相比下降至1千7百60萬元，是由於律師費用及壞帳費用減少所致。
- 二零一零年第一季的銷售和市場推廣費用由二零零九年第四季的780萬元下降至600萬元，錄得季度降幅22.1%。

## 其他收入(支出)

以千美元計	二零一零年 第一季度	二零零九年 第四季度	季度比較	二零零九年 第一季度	年度比較
其他收入(支出)	(155,567)	(29,178)	433.1%	(4,480)	3372.5%
利息收入	878	886	-0.9%	436	101.2%
利息支出	(7,784)	(2,874)	170.8%	(5,498)	41.6%
所承諾授出的股份及認 股權證之公平價值變動	(146,561)	(30,100)	386.9%	-	-
匯兌收益(虧損)	(3,241)	1,876	-	(357)	807.8%
其他，淨額	1,141	1,033	10.5%	939	21.5%

- 合併來自於經營性活動的匯兌損益，公司於二零一零年第一季整體錄得匯兌虧損 170 萬元，相對二零零九年第四季錄得匯兌收益 310 萬元。
- 二零一零年第一季其他非經營性費用包含與訴訟和解相關的股權及認購權證授予協定的公平價值的改變，金額為 1 億 4 千 6 百 60 萬元。

## 折舊及攤銷

- 二零一零年第一季的折舊及攤銷總額為 1 億 7 千 4 百 70 萬元，相較於二零零九年第四季的 1 億 8 千 3 百 80 萬元。

## 流動資金

以千美元計	二零一零年 第一季度	二零零九年 第四季度
現金及現金等價物	523,208	443,463
限制性現金	29,286	20,360
應收賬款	204,983	204,290
存貨	194,604	193,705
其他	53,687	45,240
流動資產總計	1,005,769	907,058
應付賬款	237,075	228,883
短期借款	333,795	286,864
長期借款的即期部份	204,442	205,784
其他	442,538	309,992
流動負債總計	1,217,850	1,031,523
現金比率	0.4x	0.4x
速動比率	0.6x	0.6x
流動比率	0.8x	0.8x

## 資本結構

以千美元計	二零一零年 第一季度	二零零九年 第四季度
現金及現金等價物	523,208	443,463
限制性現金	29,286	20,360
長期票據即期部分	59,163	78,608
長期票據	83,913	83,325
短期借款	333,795	286,864
長期借款的即期部份	204,442	205,784
長期借款	515,876	550,653
總借款	1,054,113	1,043,301
股東權益	1,618,038	1,796,240
總債務股本比率	65.1%	58.1%

## 現金流量概要

以千美元計	二零一零年 第一季度	二零零九年 第四季度
來自於經營活動的現金淨額	153,094	89,297
來自於投資活動的現金淨額	(64,323)	(37,804)
來自於融資活動的現金淨額	(8,762)	(60,937)
現金變動淨額	79,745	(9,822)

## 資本開支概要

- 二零一零年第一季資本開支為 6 千 4 百萬元。

## 近期公佈

- 2009 年年報 (2010-04-29)
- 通函(1)股東周年大會通告(2)重選董事(3)建議授出發行及購回股份之一般授權(4)建議根據二零零四年以股支薪獎勵計劃增加授出股權獎勵上限的特別授權及(5)建議修訂二零零四年以股支薪獎勵計劃 (2010-04-29)
- 通知信函及變更申請表格 (2010-04-29)
- 股東周年大會通告 (2010-04-29)
- 董事會會議日期通知 (2010-04-28)
- 二零零九年年度業績公佈 (2010-04-26)
- 中芯國際發布關於二零一零年第一季度財務業績及二零零九年全年業績的最新資料 (2010-04-19)
- 董事會通過刊發年度業績報告日期通知 (2010-04-13)
- 股價敏感數據-中芯國際 45LL 技術已成功完成工藝認證及 SRAM 產品認證(2010-03-30)
- 授出購股期權 (2010-02-24)
- 格科微 CMOS 圖像傳感器產品於中芯國際 8 吋晶圓出貨達 10 萬片新里程碑 (2010-02-12)
- 澄清公告 (2010-02-09)
- 中芯截至二零零九年十二月三十一日止三個月業績公佈 (2010-02-09)
- 委任商務長、營運長及財務長 (2010-02-09)
- 華虹設計基於中芯國際 0.162 微米 EEPROM 工藝產品成功進入量產 (2010-02-02)
- 董事會會議日期通知 (2010-01-25)

上述公佈詳情請參閱中芯國際網站。

*[http://www.smics.com/website/cnVersion/Press\\_Center/newsRelease.ftl](http://www.smics.com/website/cnVersion/Press_Center/newsRelease.ftl)*

**中芯國際集成電路製造有限公司**  
**合併資產負債表**

(以美元為單位,每股資料除外)

截至以下日期止

	<b>二零一零年 三月三十一日 (未經審核)</b>	<b>二零零九年 十二月三十一日 (未經審核)</b>
<b>資產</b>		
<b>流動資產：</b>		
現金及現金等價物	523,207,927	443,462,514
限定用途的現金	29,286,422	20,360,185
應收賬款，已扣除撥備分別為二零一零年三月三十一日\$96,111,136元及二零零九年十二月三十一日\$96,144,543元	204,982,678	204,290,545
存貨	194,604,324	193,705,195
預付款項及其它流動資產	32,269,099	28,881,867
待售資產	13,244,958	8,184,462
遞延稅資產的即期部分	8,173,216	8,173,216
<b>流動資產合計</b>	<b>1,005,768,624</b>	<b>907,057,984</b>
預付土地使用權	77,550,315	78,111,788
廠房及設備，淨額	2,129,575,807	2,251,614,217
購入無形資產，淨額	177,109,741	182,694,105
股權投資	9,392,886	9,848,148
其他長期預付款	214,588	391,741
遞延稅資產	98,651,547	94,358,635
<b>資產合計</b>	<b>3,498,263,508</b>	<b>3,524,076,618</b>
<b>負債及股東權益</b>		
<b>流動負債：</b>		
應付帳款	237,075,087	228,882,804
預提費用及其它流動負債	116,494,349	111,086,991
短期借款	333,794,887	286,864,063
長期票據的即期部份	59,163,022	78,608,288
長期借款的即期部份	204,442,433	205,784,080
與訴訟和解相關的股份發行及認購權證的協定	266,798,990	120,237,773
應付所得稅	81,310	58,573
<b>流動負債合計</b>	<b>1,217,850,078</b>	<b>1,031,522,572</b>

長期負債：		
長期票據	83,912,660	83,324,641
長期借款	515,875,782	550,653,099
與特許權協定相關的長期應付款	4,837,526	4,779,562
其他長期負債	21,647,675	21,679,690
遞延稅負債	1,001,293	1,035,164

<b>長期負債合計</b>	<b>627,274,936</b>	<b>661,472,156</b>
---------------	--------------------	--------------------

<b>負債合計</b>	<b>1,845,125,014</b>	<b>1,692,994,728</b>
-------------	----------------------	----------------------

非控制權益	35,100,411	34,841,507
-------	------------	------------

股東權益：

普通股，面值 0.0004 元，法定股份為 50,000,000,000 股，於二零一零年三月三十一日及二零零九年十二月三十一日法定及已發行股份分別為 22,420,895,812 股及 22,375,886,604 股。

	8,968,359	8,950,355
--	-----------	-----------

額外繳入股本	3,503,714,048	3,499,723,153
--------	---------------	---------------

累計其他綜合虧損	(648,316)	(386,163)
----------	-----------	-----------

累計虧絀	(1,893,996,008)	(1,712,046,962)
------	-----------------	-----------------

<b>所有股東權益合計</b>	<b>1,618,038,083</b>	<b>1,796,240,383</b>
-----------------	----------------------	----------------------

<b>總負債，非控制權益及股東權益合計</b>	<b>3,498,263,508</b>	<b>3,524,076,618</b>
-------------------------	----------------------	----------------------

中 芯 國 際 集 成 電 路 製 造 有 限 公 司

合 併 營 運 報 表

(以美元為單位)

	截至以下日期止三個月	
	二零一零年 三月三十一日 (未經審核)	二零零九年 十二月三十一日 (未經審核)
銷售額	351,724,012	333,089,885
銷售成本	300,270,177	307,688,812
<b>毛利</b>	<b>51,453,835</b>	<b>25,421,073</b>
經營費用：		
研究和開發	43,592,355	43,805,597
一般及行政	17,601,140	151,519,965
銷售和市場推廣	6,045,489	7,759,965
購入無形資產攤銷	6,885,746	7,640,689
長期資產減值損失	5,137,925	138,294,783
來自廠房設備和其他固定資產的銷售 損失	233,053	3,585,371
訴訟和解	-	269,637,431
<b>經營費用總額</b>	<b>79,495,708</b>	<b>622,243,801</b>
<b>經營虧損</b>	<b>(28,041,873)</b>	<b>(596,822,728)</b>
其他收入(支出)：		
利息收入	877,711	886,374
利息支出	(7,783,555)	(2,873,955)
所承諾授出的股份及認股權證之公平 價值變動	(146,561,217)	(30,100,793)
匯兌收益(損失)	(3,241,001)	1,876,327
其他,淨額	1,140,502	1,033,481
<b>其他支出,淨額</b>	<b>(155,567,560)</b>	<b>(29,178,566)</b>
<b>所得稅前虧損</b>	<b>(183,609,433)</b>	<b>(626,001,294)</b>
所得稅利益	2,374,552	8,735,242
股權投資虧損	(455,261)	(114,272)
<b>淨虧損</b>	<b>(181,690,142)</b>	<b>(617,380,324)</b>

非控制權益持有人利息	(258,904)	(274,320)
中芯國際應佔虧損	<b>(181,949,046)</b>	<b>(617,654,644)</b>
每股股份淨虧損，基本及攤薄	(0.01)	(0.03)
每股美國預托股份淨虧損，基本及攤薄	(0.41)	(1.38)
<b>用作計算基本及攤薄每股普通股 虧損額的股份</b>	<b>22,396,835,456</b>	<b>22,370,036,361</b>



**中 芯 國 際 集 成 電 路 製 造 有 限 公 司**  
**合 併 現 金 流 量 表**  
(以美元為單位)

截至以下日期止三個月

	二零一零年 三月三十一日 (未經審核)	二零零九年 十二月三十一日 (未經審核)
<b>經營活動:</b>		
<b>淨虧損</b>	<b>(181,690,142)</b>	<b>(617,380,324)</b>
<b>淨虧損至經營活動所得(所耗)現金淨額對賬的 調整:</b>		
遞延稅	(4,326,783)	(8,786,497)
處置設備及其它長期資產損失	233,053	3,585,371
折舊及攤銷	164,246,614	173,502,837
購入無形資產攤銷	6,885,746	7,640,689
股權報酬	3,583,507	2,620,497
長期票據及與特許權協定相關的長期應付款的 非現金利息費用	1,129,497	1,068,177
股權投資虧損	455,261	114,272
長期資產減值損失	5,137,925	138,294,783
訴訟和解(非現金部分)	-	239,637,431
股權及認購權證授予協定的公平價值改變 備抵呆帳	146,561,217 (33,407)	30,100,793 110,755,616
<b>營運資產及負債的變動:</b>		
應收賬款，淨額	(658,725)	(22,556,104)
存貨	(899,129)	(6,865,736)
預付款及其它流動資產	(3,210,079)	29,771,367
應付賬款	8,714,410	4,697,376
預提費用及其它流動負債	6,973,898	(8,654,694)
應付所得稅	22,737	(3,928,422)
其他長期負債	(32,015)	15,679,690
<b>經營活動所得現金淨額</b>	<b>153,093,585</b>	<b>89,297,122</b>
<b>投資活動:</b>		
購入廠房、設備及土地使用權	(72,950,296)	(49,052,074)

政府授予購買廠房及設備所得款項	23,884,935	13,450,232
出售設備所得款項	5,045,012	1,427,816
出售待售資產所得款項	1,286,854	737,986
購買所獲無形資產	(12,663,539)	(10,189,252)
購買短期投資	(2,668,692)	(6,802,116)
出售短期投資	2,668,692	12,912,347
轉換限定用途的現金	(8,926,238)	(289,409)
<b>投資活動所耗現金淨額</b>	<b>(64,323,272)</b>	<b>(37,804,470)</b>
<b>融資活動:</b>		
短期借款所得款項	171,264,418	175,741,829
償還短期借款支付的款項	(124,333,593)	(170,120,268)
長期借款所得款項	10,000,000	49,195,984
償還長期借款支付的款項	(46,118,964)	(115,850,696)
償還長期票據支付的款項	(20,000,000)	-
行使雇員購股權所得款項	425,392	96,012
<b>融資活動所耗現金淨額</b>	<b>(8,762,747)</b>	<b>(60,937,139)</b>
匯率變動的影響	(262,153)	(377,869)
<b>現金及現金等價物增加(減少)淨額</b>	<b>79,745,413</b>	<b>(9,822,356)</b>
<b>現金及現金等價物—期間開始</b>	<b>443,462,514</b>	<b>453,284,870</b>
<b>現金及現金等價物—期間結束</b>	<b>523,207,927</b>	<b>443,462,514</b>

於本公告日期，本公司董事分別為董事會主席兼獨立非執行董事江上舟先生、本公司總裁兼首席執行官兼執行董事王寧國博士、本公司非執行董事陳山枝先生、高永崗先生及周杰先生(及周杰先生的替任董事汪正綱先生)，以及本公司獨立非執行董事川西剛先生、陳立武先生。

承董事會命  
**中芯國際集成電路製造有限公司**  
王寧國  
總裁，首席執行官  
執行董事

中國上海

二零一零年五月十一日

\* 僅供識別